

AIデータセンター向け基板 ダイシング精度低下、その原因は“工具”にありますか？

AIデータセンター向け高密度基板のダイシング加工では、 μm 単位の精度と安定性が常に求められます。
しかし現場では、こんなトラブルが増えています。

こんなお困りごとはありませんか？

セラミック・ガラス系基板の研削粉により

■ダイシング砥石を固定しているツール(ハブ・フランジ部)が削れる

■ツール摩耗による砥石の芯ズレ・ブレ発生

その結果、

- 切断面が曲がる・蛇行する
- 切断精度不良・チッピング増加
- ダイシング装置のタンク容量が小さく
- 切削液の劣化が早い

原因は、切削液中に滞留する

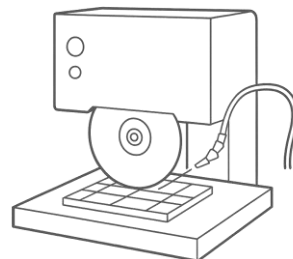
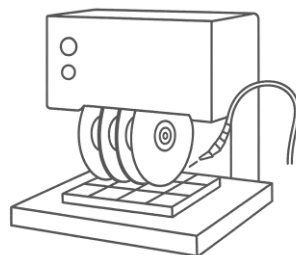
→微細なセラミック・ガラス研削粉

研削粉が切削液中に循環したままになると、

- 砥石固定ツールへの研磨作用
- ツール摩耗 → 砥石保持精度低下
- 切削抵抗の不安定化

といった問題を引き起こし、

砥石そのものではなく「ツール側」が先に壊れる現象が発生します。



遠心分離機との違い

項目	当社ろ過装置（マイクロキャッチ）	遠心分離機
ろ過精度	○ 微細な研削粉まで対応可能	× 微細粉は分離できず残留
メンテナンス	○ フィルター自動排出・作業負担が少ない	× カマ掃除が必要で負担大

解決策は次ページをご覧ください。

解決策

ダイシング装置に最適化した 1 μ m前後のフィルタリング

- 微細研削粉を確実に捕捉
- ツール摩耗の進行を抑制
- 小型タンク装置の弱点を補完

ダイシング装置2台を一括ろ過

集中管理タンク方式にも対応

ダイシング工程専用設計

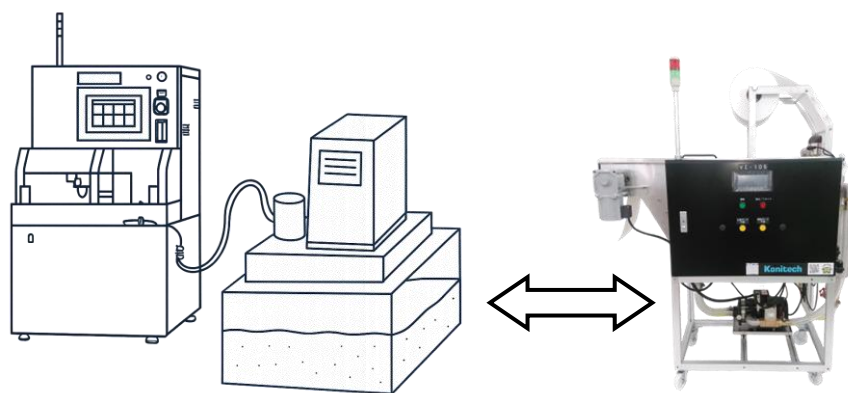
(※切削液使用工程向け／純水は対象外)

導入効果(実績)

- 砥石固定ツールの異常摩耗・突然破損を低減
- 砥石の保持精度が安定
→ 切断面の直進性・再現性向上
- 切削液交換頻度削減
→ 稼働率向上
- 精度不良・再加工の抑制

AI基板ダイシングの安定稼働は「刃物」ではなく「液管理」から。

ダイシング装置2台同時対応、集中管理タンク方式での導入実績があります。



▶ デモ・評価のご相談受付中

ろ過技術を基盤としたこれまでの経験から、
貴社の加工方法に合った改善の考え方を
一緒に整理できればと考えています。

まずは30分ほど、

実例を踏まえてオンラインで情報交換しませんか？

▶ お問い合わせはここからも可能です

https://www.konitech.kyoto.jp/?page_id=7



コニテック株式会社
担当:松田 裕
住所 〒600-8899
京都市下京区西七条赤社町10番地
電話:075-311-7799 FAX:075-311-7798
携帯:090-5069-7039
ホーム:<https://www.konitech.kyoto.jp/>

Konitech